

低温域 (170°C~190°C) で鉛フリーはんだ接合を実現

Lead free solder for Low temperature soldering (170°C - 190°C)

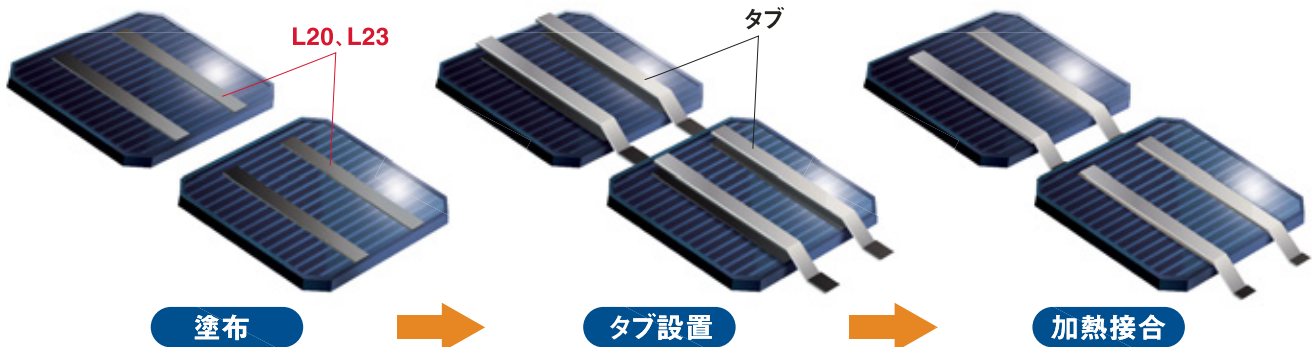
特長

- 低温域リフローにより、部品の熱衝撃を和らげる。
- 低温域リフローにより、セルの反りを抑制。
- リフロー温度低下により、省エネ化を実現 (従来比約30%削減)。



工法提案例

□ はんだペーストを使用した提案例

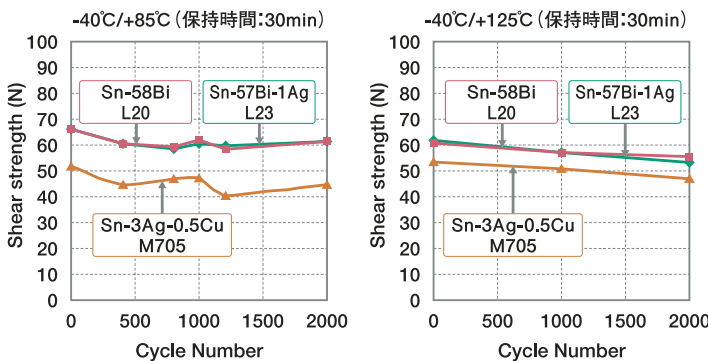


□ タブをL20、L23でコーティングした提案例



製品仕様

□ 温度サイクル試験データ ※3216R実装部品でのデータ



□ 消費電力データ

